

# eDRAM最適仕様 計算プログラム 操作マニュアル

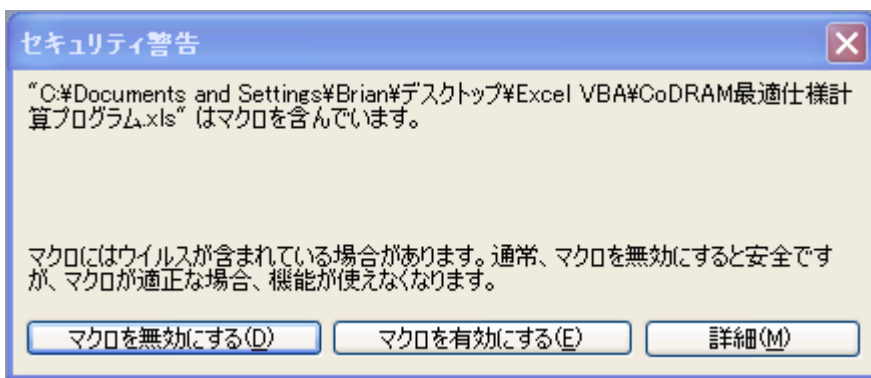
Sorbus Memory, Inc.

# 1.プログラムの起動

<対応Software> Excel 2000またはExcel 2003を推奨  
(Excel 2007では未確認)



## プログラム起動



“マクロを有効にする”をクリック

## <メニュー画面>

設計製品の基本情報		
項目	入力値	計算値
メモリ容量 (bits)	256M	268,435,456
ロウアドレス本数	13	8,192
カラムアドレス本数	9	512
ビット幅	16	
バンク数	4	
デザインルール (nm)	90	
Waferサイズ (mm)	300	
電源電圧 (V)	1.8	
クロック周波数 (MHz)	166	
Wafer 価格 (US\$)	2,000.00	

①
クリア
②
計算
③

計算結果	
チップサイズ X (mm)	
チップサイズ Y (mm)	
チップ面積 (mm <sup>2</sup> )	
有効チップ数	
KGDチップ総コスト (US\$)	
バースト電流 [All bank] (mA)	
インターフェイス電流 (mA)	
消費電力 [All bank/Bank interleave] (mW)	

①クリアボタンを押し、データをクリアする

②設計製品の基本情報を入力

③計算を実行する

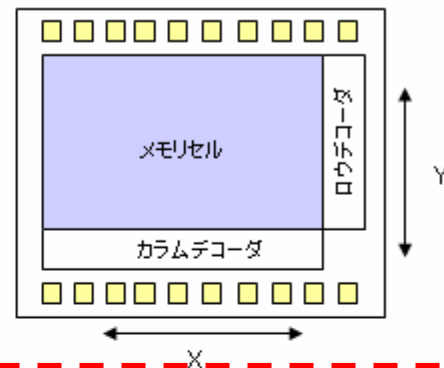
Wafer価格以外は、各項目ごとに  
選択肢の中から選択する

入力値	
256M	
128M	
256M	
512M	
1G	
	16
	4
	90
	300
	1.8
	166
	2,000.00

### 3.計算結果の確認

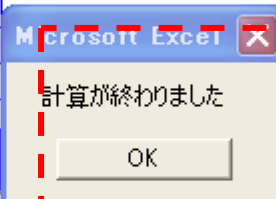
#### 設計製品の基本情報

項目	入力値	計算値
メモリ容量 (bits)	256M	268,435,456
ロウアドレス本数	13	8,192
カラムアドレス本数	9	512
ビット幅	16	
バンク数	4	
デザインルール (nm)	90	
Waferサイズ (mm)	300	
電源電圧 (V)	1.8	
クロック周波数 (MHz)	166	
Wafer 価格 (US\$)	2,000.00	



クリア

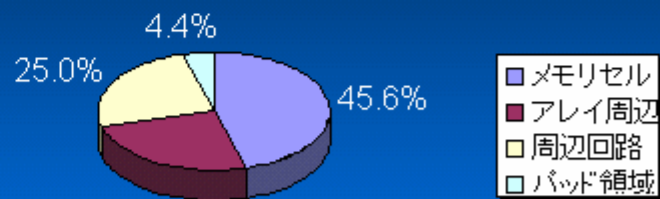
計算



#### 計算結果

チップサイズ X (mm)	7.70
チップサイズ Y (mm)	4.95
チップ面積 (mm <sup>2</sup> )	38.12
有効チップ数	1,605
KGDチップ総コスト (US\$)	1.95
バースト電流 [All bank] (mA)	64.25
インターフェイス電流 (mA)	8.50
消費電力 [All bank/Bank interleave] (mW)	138.23

#### チップサイズ分析



計算結果の確認

グラフの確認